

PCB加工和贴片生产说明

设计

- 六层通孔板
- 板框尺寸：48mm x 28.6mm
- 最小线宽：0.1mm/4mil
- 最小线距：0.1mm/4mil
- 最小通孔（镀铜）：外径0.4mm，内径0.2mm/8mil，孔环0.1mm/4mil
- 最小阻焊宽度：0.15mm/6mil

叠层

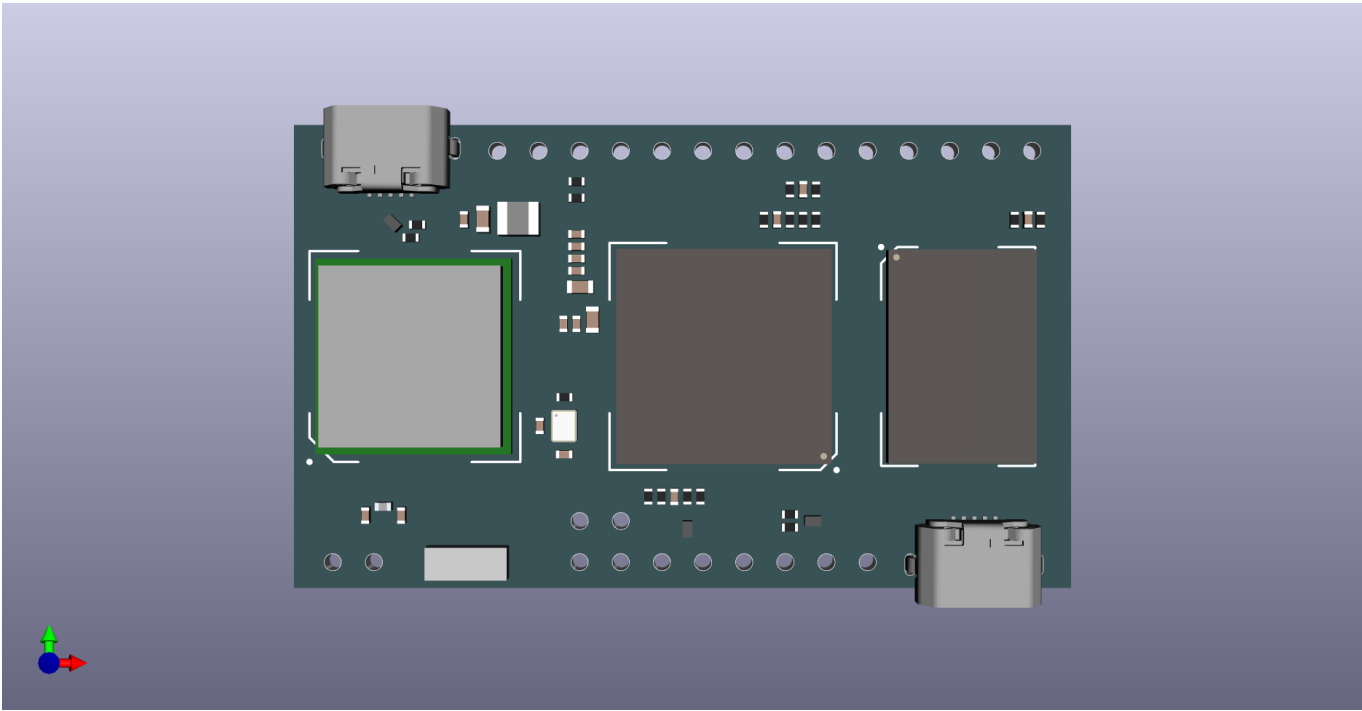
层	材料	厚度	说明
1	铜	2.4mil，1oz	top
-	FR4	3.6mil	
2	铜	1.2mil，1/2oz	In1，地平面
-	FR4	4.6mil	
3	铜	1.2mil，1/2oz	In2，信号
-	FR4	36mil	
4	铜	1.2mil，1/2oz	In3，信号
-	FR4	4.6mil	
5	铜	1.2mil，1/2oz	In4，电源平面
-	FR4	3.6mil	
6	铜	2.4mil，1oz	bottom

总厚度：59.6mil ~ = 1.5mm

拼板

需加工方实现拼板。

如下图所示，注意板边缘的micro USB连接器凸出板边0.8mm。拼板时长边间距应不少于1mm，避免贴片时发生物料干涉。



加工文件清单

文件名	格式	说明
require.drl	Excellon	钻孔文件
require-Edge.Cuts.gbr	gerber	板框
require-F.Cu.gbr	gerber	正面
require-In1.Cu.gbr	gerber	内层1
require-In2.Cu.gbr	gerber	内层2
require-In3-Cu.gbr	gerber	内层3
require-In4-Cu.gbr	gerber	内层4
require-B.Cu.gbr	gerber	背面
require-F.Mask.gbr	gerber	正面阻焊
require-B.Mask.gbr	gerber	背面阻焊
require-F.Paste.gbr	gerber	正面钢网/锡膏
require-B.Paste.gbr	gerber	背面钢网/锡膏
require-F.Fab.gbr	gerber	正面摆件位置
require-B.Fab.gbr	gerber	背面摆件位置
require.bom	文本文件	BOM（尚未提供）

贴片说明

- 1. Fab文件内，除microUSB连接器之外其他器件均以器件中心点为摆件位置；

2. 除IC，天线和静电管（ESD）器件之外，所有器件为无极性器件，无摆件方向；
3. IC均以丝印标注1脚位置，圆点或三角；
4. 天线和静电管，无丝印，引脚焊盘不对称，可通过FAB文件或焊盘确定摆件方向；